

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-018

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	中邮电子
时间	2024年6月14日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司显示业务终端产品电子标签的主要客户是？ 答：目前主要有晶门科技、晶宏半导体股份有限公司等客户。</p> <p>2. 问：近期黄金价格上涨，对于公司产品成本是否有所影响？ 答：黄金主要用于显示驱动芯片上，而公司目前生产上所用到的黄金成本基本可转嫁至下游客户，由其承担价格波动的主要风险，因此近期的黄金价格波动对公司产品成本影响不大。</p> <p>3. 问：公司海外客户的拓展情况？ 答：公司持续扩大业务覆盖面，已成功将经营触角延伸至日韩等海外客户。</p> <p>4. 问：公司机器设备的供应商是否有境外厂商？ 答：目前公司仍有部分机器设备由境外供应商提供，但公司已陆续对多数机器设备逐步进行国产替代化，与国内优质厂商展开合作。</p> <p>5. 问：铜镍金凸块的技术优势？ 答：铜镍金凸块是对传统引线键合（Wire bonding）封装方式的优化方案。具体而言，铜镍金凸块可以通过大幅增加芯片表面凸块的面积，在不改变芯片内部原有线路结构的基础之上，对原有芯片进行重新布线（RDL），大大提高了引线键合的灵活性。此外，铜镍金凸块中铜的占比相对较高，因而具有天然的成本优势。由于电源管理芯片需要具备高可靠、高电流等特性，且常常需要在高温的环境下使用，而铜镍金凸块可以满足上述要求并大幅降低导通电阻，因此铜镍金凸块目前主要应用</p>

	于电源管理类芯片。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月17日